



SP + Digital



/governosp



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

Comunicados	sua conta	Procedimentos	Relatórios	Sanções	Catálogo
Sair					

10:27:26



Número da OC 102114100582023OC00008 - Itens

negociados pelo valor total

Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

UC SECR. DESENV. ECONOMICO USP-INST.DE

ASTRONOMIA, GEO. C. ATMOSFERICA

Fase Preparatória

Edital e Anexos

Pregão

Gestão de Prazos

Atos Decisórios

03853966861 Maria Aparecida Filipe

[Voltar](#)

Pergunta

CHIP DE SEGURANÇA TPM VERSÃO 2.0

06/09/2023 18:28:07

ALAMO COMERCIO, SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI

Boa noite, é solicitado nas especificações Técnicas do Edital:

2.4. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia:

2.4.1. Não será aceita solução via firmware;

2.4.2. A função deve ser entregue ativada e pronta para uso;

Será aceito essa funcionalidade, através da adição de módulo TPM 2.0 opcional, em conector disponível na placa mãe, proprio para essa funcionalidade??

Muito obrigado;

Resposta

Maria Aparecida Filipe

11/09/2023 10:26:50

A pregoeira informa a resposta da Equipe Técnica de Informática do IAG, quanto ao esclarecimento solicitado, a saber:

“Sim, desde que a solução apresentada seja nativa (exista previamente conector na placa mãe) será aceito. ”

Ouvidoria

Transparência

SIC

